

第7回 SSIS-NEDIA 関西シンポジウム開催案内



2020年7月

一般社団法人 半導体産業人協会 関西地区委員長

一般社団法人 日本電子デバイス産業協会 関西 NEDIA 代表

第7回 SSIS-NEDIA 関西シンポジウム

「5G 時代いよいよスタートそして Beyond 5G へ」

SSIS-NEDIA 関西シンポジウム は、2014年よりスタートし、第1回は「電子デバイスの新たな挑戦」をテーマにこれからの日本の電子デバイスの方向性について、第2回は「新アプリを実現する次世代インテグレーション」、第3回は「スモール製造によるビジネスモデルの変革」、第4回は「インテリジェントカーがもたらす電子デバイスの進化」、第5回は「半導体が牽引する自動車の進化」、第6回は「スマートセンシングの進化と応用」をテーマとして講演・議論及び交流会を開催してきました。

第7回となります今年も、「5G 時代いよいよスタートそして Beyond 5G へ」をテーマとして、デジタル社会に必須となる 5G が本格的商用化を迎える中で、その先も見据えたトレンド及び 5G 時代を支える電子部品、端末の動向について、その分野でそれぞれご活躍の講師をお招きしてご講演いただきます。

新型コロナウイルス感染防止の観点から、今回は申し訳ありませんが、講演終了後の交流会は中止とさせていただきます。

大変貴重な機会ですので皆様多数のご参加をお待ち申し上げます。

開催日時：2020年9月1日（火）13:30～17:15

開催会場：大阪大学中之島センター 7F 講義室 703

大阪市北区中之島 4-3-53、<http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/>

主催：一般社団法人 半導体産業人協会（SSIS）

一般社団法人 日本電子デバイス産業協会（NEDIA）

参加費：SSIS、NEDIA 会員：2,000 円

非会員： 5,000 円

学生： 無料

*参加費は当日受付にてお支払い下さい。

「プログラム」

13:30 - 13:40 開会の挨拶 SSIS 理事長 内海 忠 氏

13:40 - 13:50 ご来賓挨拶 近畿経済産業局(予定)

13:50 - 14:50 講演 1 「 5G 及びその後に対する取り組み 」

株式会社 NTT ドコモ ネットワークイノベーション研究所 担当部長 鈴木 恭宜 氏

要旨：第 5 世代移動通信システム(5G)の特徴は、従来の高速大容量伝送に加え、低遅延でのネットワーク接続、IoT デバイスなどを多数収容できることにある。

5G はさまざまな利用シーンで画期的なサービス提供が期待されている。また、将来の機能拡張を全体として 5G Evolution、10 年後のサービス提供を目指す第 6 世代移動通信システム(6G)のコンセプト検討が世界の携帯電話事業者と通信機器ベンダーにて始まっている。本講演では、これまで弊社にて実施してきた 5G のさまざまなユースケースを述べる。また、5G Evolution と 6G に向けた弊社の取り組みについて述べる。

14:50 - 15:50 講演 2 「 5G に向けたミリ波技術 」

株式会社 村田製作所 モジュール事業本部 通信モジュール事業部

リサーチャー 上田 英樹 氏

要旨：5G は、移動通信システムとして初めてミリ波帯を用いる通信規格である。ミリ波帯では、既存の周波数帯と比較して広い帯域が使用可能であり、5G で求められる高速・大容量通信への期待が高い。一方で周波数が高いために、電子デバイスにはさまざまな新規要素技術が必要となる。ミリ波帯ではアンテナ・配線での損失が大きくなるため、RFIC とアンテナを小型・一体化した、モジュールの『パッケージング技術』が求められる。アンテナ一体型モジュールの実現には、高効率な『アンテナ設計技術』とそれを支える『シミュレーション技術』、低損失な『基板材料技術』、モジュールの『測定・評価技術』が重要である。また、ミリ波 5G を普及させるための低コストな『量産・検査技術』も同時に必要となる。講演では、各要素技術に関する議論や、弊社の取り組みを紹介する。

15:50 - 16:05 休憩

16:05 - 17:05 講演 3 「 5G 対応スマートフォンの商品開発事例及び今後の動向 」

シャープ株式会社 通信事業本部 パーソナル通信事業部 システム開発部

部長 前田 健次 氏

要旨：弊社は、本年春の国内 5G 開始に合わせて、5G 対応のスマートフォン、モバイルルータを商品化しました。5G 対応商品には、「高速・大容量通信」を実現する電子デバイスが多数搭載されていますが、端末性能を最大限活用するためには、発熱/消費電力等の様々な技術課題に対する取り組みが必要です。本講では、5G 端末活用事例を示しながら、今後の電子デバイスに期待される性能や実装技術について紹介します。

17:05 - 17:15 閉会の挨拶 NEDIA 代表理事・会長 齋藤昇三 氏

お申込み：

以下のフォーマットにご記入の上、SSIS 半導体産業人協会事務局 Email:info@ssis.or.jpまでメールにてご連絡ください。確認後、メール返信させていただきます。

申込締切：8月24日（月）（定員50名に達し次第締め切らせていただきます）

-----第7回 SSIS-NEDIA 関西シンポジウム参加申込-----

会社・団体名：

部署・ご役職：

氏名：

連絡先：

会員確認： SSIS 会員・NEDIA 会員・非会員・学生（該当するものを残してください）
